

**HIGH THERMAL PERFORMANCE GAP FILLER 6.0W/m-K**

**Features and Benefits**

- Superior thermal performance
- 6.0W/m-K thermal conductivity
- Electrically isolating
- RoHS compliant
- Halogen-free



**Typical Applications**

- Notebook Computers
- Handheld Portable Electronics
- Micro Heat Pipe assemblies
- Micro Processors, Memory Chips and Graphic Processors
- Motor Control
- Wireless Communication Hardware

**Optional Configurations**

- Can be die-cut into other dimensions

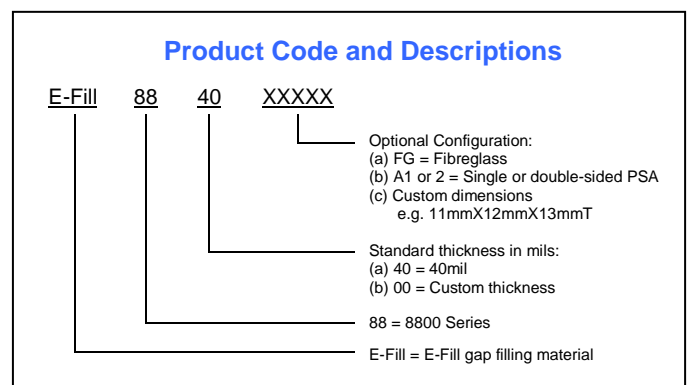
The proprietary boron nitride formula of E-fill 8800 offers superior thermal performance with moderate compressibility.

This thermal conductive gap filler is electrically non-conductive and stable from -40~200°C. Its RoHS compliant and halogen-free status makes it an ideal gap filler for hazardous substance sensitive applications.

Properties	E-Fill 8800 Series	Test Method
Construction & Composition	Boron nitride filled silicone elastomer	—
Color	Yellow	Visual
Thickness Range /inch (mm)	0.01"~0.40" (0.254~10.16) in 0.01" (0.254) increments	—
Standard Sheet Size	9" x 9"	—
Density /g.cm <sup>-3</sup>	1.40	—
Hardness /Shore 00	70	ASTM D2240
Tensile Strength /psi	52	ASTM D412
UL Flammability Rating	UL94 HB	E109346
Temperature Range /°C	-40°C~200°C	—
Thermal Conductivity /W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup>	6.0	ASTM D5470 (modified)
Breakdown Voltage /V	>3000 (Thickness ≤ 0.02") >5000 (Thickness = 0.03~0.05") >6000 (Thickness ≥ 0.06")	ASTM D149
Volume Resistivity /ohm.cm	4.1 x 10 <sup>13</sup>	ASTM D257
Dielectric Constant @ 1MHz	3.5	ASTM D150
Shelf Life	24 months	—

Please contact us for other special requirements

Carrier Treatment	Criteria
Fiber Glass (FG)	Compulsory for ≤ 0.02" (0.5mm)
Rubberized Cloth (RC)	Not Recommended
Pressure Sensitive Adhesive (PSA)	Not Recommended
Detachable Adhesive (DA)	Not Recommended
Aluminum Foil (AL)	Not Recommended
Kapton (PI)	Not Recommended
Talc treatment (DAT)	Not Recommended



**香港**  
Tel: (852) 2686 8168  
Fax: (852) 2686 8268  
E-mail: emeihk@emeigroup.com

**东莞**  
Tel: (86) 769-8334 1628  
Fax: (86) 769-8334 2028  
E-mail: emeidg@emeigroup.com

**上海**  
Tel: (86) 21-5868 3381  
Fax: (86) 21-5868 3386  
E-mail: emeish@emeigroup.com

**台湾**  
Tel: (886) 2-2793 9055  
Fax: (886) 2-2793 9501  
E-mail: emeitw@emeigroup.com

**产品特点**

- 出众的导热性能
- 导热率 6.0W/m-K
- 电绝缘
- 符合 RoHS 规格
- 无卤素



**一般应用**

- 电子笔记本
- 手提电子器材
- 微热管组件
- 微处理器，内存芯片，图形处理器
- 底盘，框架或其他散热组件
- 电机控制器
- 通信用硬件

**其他配置**

- 可模切成特定尺寸

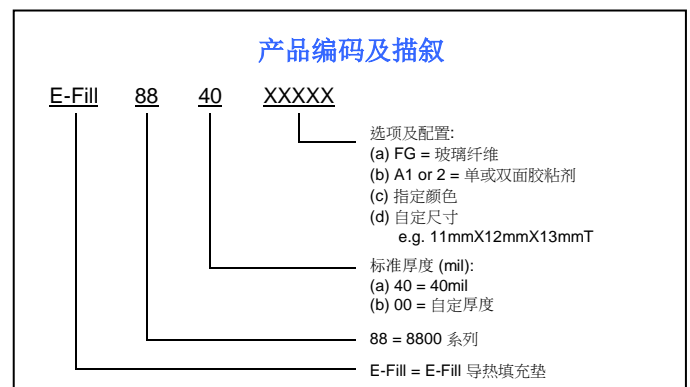
E-Fill 8800 独有的氮化硼配方能够提供高导热性能及同时达到中等压缩比的要求。

Fill 8800 的工作温度为-40~200℃而且具有电绝缘特性，符合 RoHS 规格和不含卤素的特点令客户在使用时对于有害物质的控制更有信心。

一般特性	E-Fill 8800 系列	测试方法
结构及主要成分	含氮化硼树脂弹性体	—
颜色	黄色	目测
厚度 /inch (mm)	0.01"~0.40" (0.254~10.16) 以 0.01" (0.254)为基本增量单位	—
标准片材尺寸	9" x 9"	—
密度 /g.cm <sup>-3</sup>	1.40	—
硬度 /Shore 00	70	ASTM D2240
拉伸强度 /psi	52	ASTM D412
UL 燃烧等级	UL94 HB	E109346
使用温度 /℃	-40℃~200℃	—
导热率 W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup>	6.0	ASTM D5470 (modified)
击穿电压/V	>3000 (厚度 ≤ 0.02") >5000 (厚度 = 0.03~0.05") >6000 (厚度 ≥ 0.06")	ASTM D149
体积电阻率 /ohm.cm	4.1 x 10 <sup>13</sup>	ASTM D257
介电常数@ 1MHz	3.5	ASTM D150
有效期	24 months	—

如对产品有特殊要求，请联系我们

载体	标准
玻璃纤维 (FG)	厚度 ≤0.02" (0.5mm)必须使用
胶布 (RC)	不建议使用
压敏胶 (PSA)	不建议使用
不粘胶 (DA)	不建议使用
铝箔 (AL)	不建议使用
聚酰亚胺膜 (PI)	不建议使用
滑石粉处理 (DAT)	不建议使用



**香港**

Tel: (852) 2686 8168  
 Fax: (852) 2686 8268  
 E-mail: emeihk@emeigroup.com

**东莞**

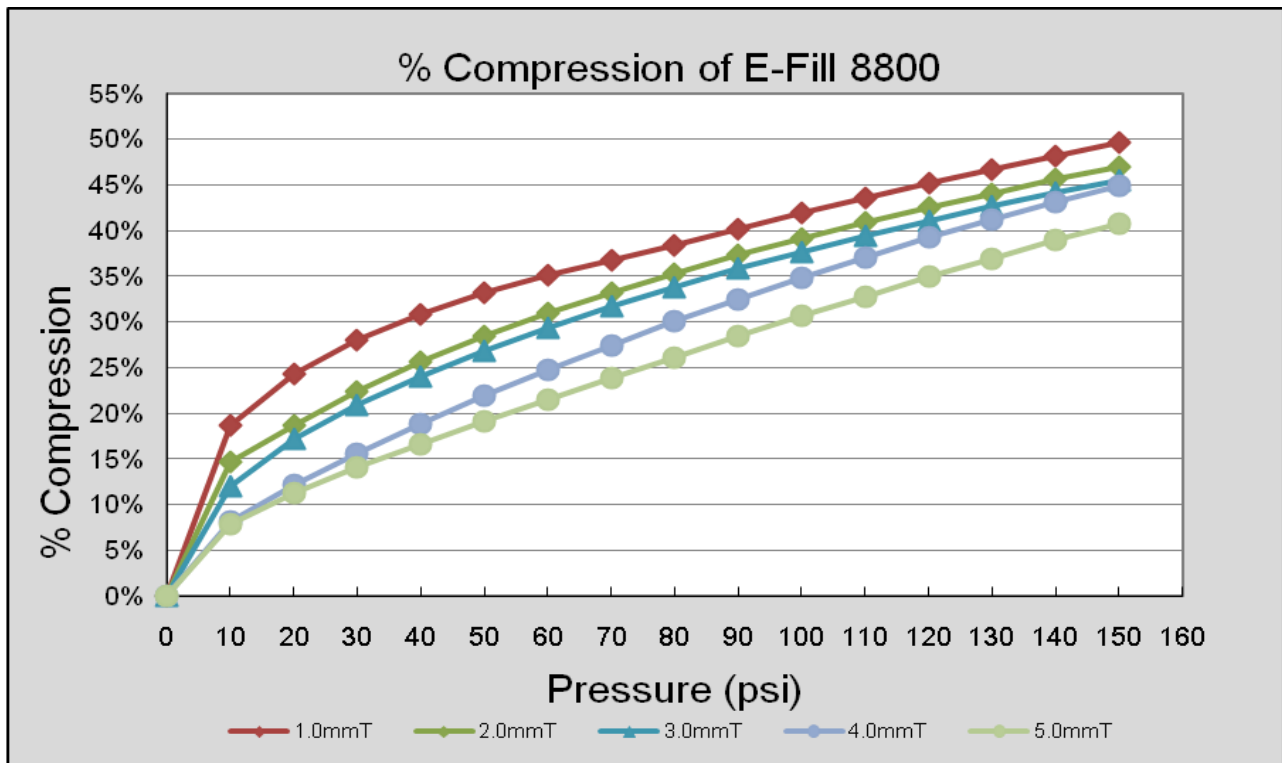
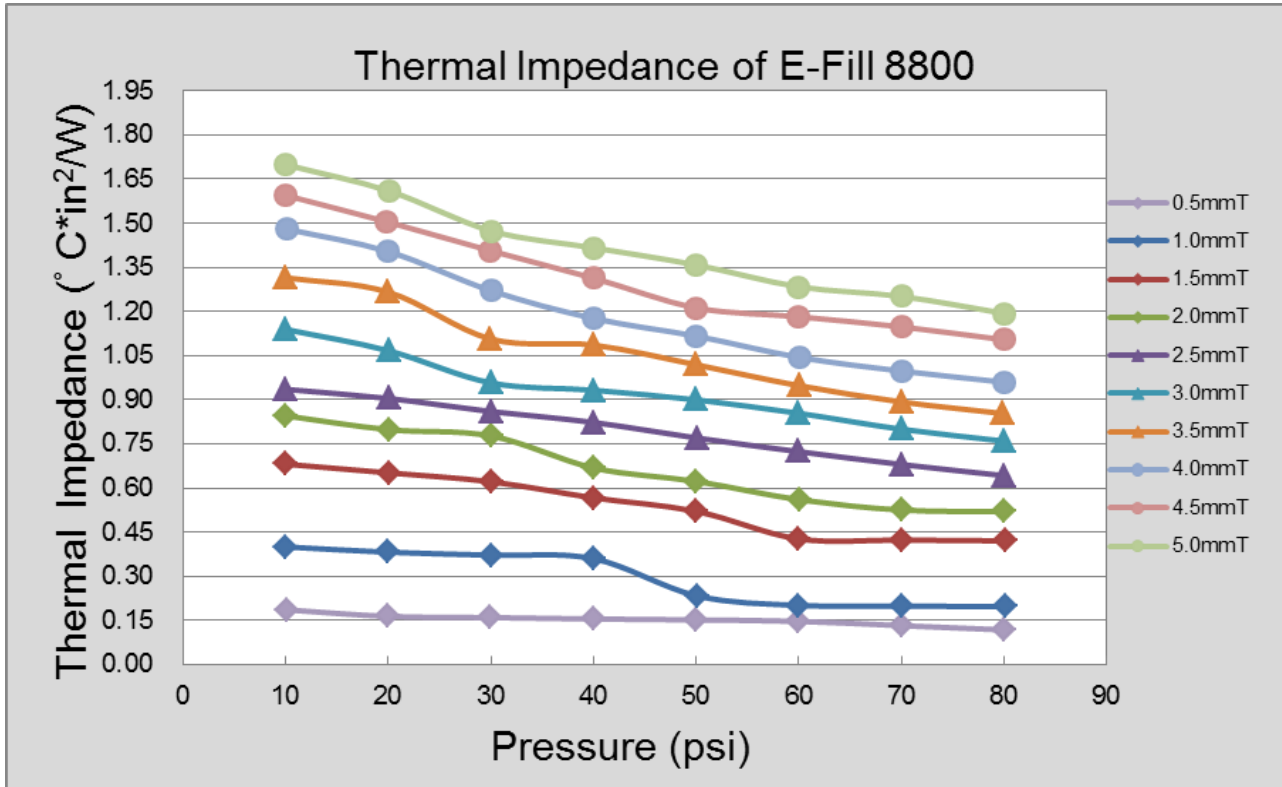
(86) 769-8334 1628  
 (86) 769-8334 2028  
 emeidg@emeigroup.com

**上海**

(86) 21-5868 3381  
 (86) 21-5868 3386  
 emeish@emeigroup.com

**台湾**

(886) 2-2793 9055  
 (886) 2-2793 9501  
 emeitw@emeigroup.com



<p><b>香港</b></p> <p>Tel: (852) 2686 8168 Fax: (852) 2686 8268 E-mail: emeihk@emeigroup.com</p>	<p><b>东莞</b></p> <p>(86) 769-8334 1628 (86) 769-8334 2028 emeidg@emeigroup.com</p>	<p><b>上海</b></p> <p>(86) 21-5868 3381 (86) 21-5868 3386 emeish@emeigroup.com</p>	<p><b>台湾</b></p> <p>(886) 2-2793 9055 (886) 2-2793 9501 emeitw@emeigroup.com</p>
--	--	--	--